



三明学院

SANMING UNIVERSITY

集成电路（先进封装）

微专业

课程教学大纲

二〇二三年十二月

目 录

EDA

_____ ()

				2
			32	0
A				
B				
C	1.			
	2.			
	3.			i
	4.			

D					
E					
			3	5	
			4	0	6
			8	0	14
			8	0	8
			4	0	6
			5		6
			32	0	32
F					
G				3	

1	介 半导体 料、器件基 制	2、4	1、			堂 授+实作 学习+ 导向 学习
2	介 半导体工 技 基		1、2			堂 授+实作 学习
3	体单 技		1、2			堂 授+实作 学习
4	区 单 ; 化 体		1、2			堂 授+实作 学习
5	化 , 分布分		1、2			堂 授+实作 学习
6	二 化 掩 性、 化 、 化层厚度分 、 化 拟		1、2			堂 授+实作 学习
7	光学光刻	3、4	2、			堂 授+实作 学习
8	新一代光刻技		2、4			堂 授+实作 学习

	9	光刻 拟	2、 3、4			堂 授+实作 学习
	10	刻	2、4			堂 授+实作 学习
	11	干 刻 及仿	3			堂 授+实作 学习
	12	基 扩散工	1、2			堂 授+实作 学习
	13	子 入分布	1、2			堂 授+实作 学习
	14	入损伤和 , 入 关工	1、2			堂 授+实作 学习
	15	化学	1、2			堂 授+实作 学习
	16	分子 外延及 和 分	1、 2、4			堂 授+实作 学习
	17	, 多 , 属化	1、2			堂 授+实作 学习
	18	成 封 及工 控 制; 新工 技	1、2			堂 授+实作 学习
H						
		平 (30%)			1 2 3 4	
		(70%)			1 2 3	
I	1.					2020 6

J	
K	
<p>备 注：</p> <p>1. 教学大纲 F—J 同一 不同授 教师应协同 成共同 心内 。 教学工作指导小 审 教学大纲 不宜 改。</p> <p>2. 评价方式可参 下列方式：</p> <p>(1) 评价：平 小 、 中 、</p> <p>(2) 实作 价： 作业、实作成品、日常 、 、 察</p> <p>(3) 价：书 报告、专</p> <p>(4) 口 价：口头报告、口</p>	

_____ ()

	EDA				
					2
			32		16
A	C				
B	<p>EDA (HDL) ASI C FPGA</p> <p>HDL SoC</p> <p>FPGA_Verilog HDL</p> <p>Verilog_HDL</p> <p>Verilog_HDL FPGA Verilog_HDL</p>				
	1. FPGA_Verilog HDL				

C	2. FPGA_Veril og HDL			
	3. FPGA_Veril og HDL			
	4. FPGA_Veril og HDL ;			
	5.			
D				
E				
		4	2	4
		4	2	4
		2	2	6
		2	2	4
		4	2	6
		0	6	6
	16	16	32	

F



3

G

_____ ()

				2
			48	16
A				
B	fl i p chi p			
C	1. 2. 3. 4.			

D

E

	5		1 2 3 4			+
	6	EDA	1 2 3 4			+
H						
	10%		10 1 / 0.25/	9 0.5/ 0.5-1 10		1 2 3 4
	30%					1 2 3 4
	60%			+		1 2 3 4
I	(1) (2)					
J						
K						
<p>备 注：</p> <p>1. 教学大纲 F—J 同一 不同授 教师应协同 成共同 心内 。 教学工作指导小 审 教学大纲 不宜 改。</p> <p>2. 评价方式可参 下列方式：</p> <p>(1) 评价：平 小 、 中 、</p> <p>(2) 实作 价： 作业、实作成品、日常 、 、 察</p> <p>(3) 价：书 报告、专</p> <p>(4) 口 价：口头报告、口</p>						

_____ ()

				2
			48	16
A				
B	Si P			
C	1. 2. 3. 4.			

D					
E					
		Si P	2	2	4
		Si P	2	4	6
		Si P	4	8	12
		Si P	4	8	12
		Si P	2	6	8
		Si P	2	4	6
			16	32	48
F	<p style="text-align: center;">_____</p>				
G				3	
	1	Si P	1 2 3 4		+
	2	Si P	1 2 3 4		+
	3	Si P	1 2 3 4		+
4	Si P	1 2 3 4		+	

	5	Si P	1 2 3 4			+
	6	Si P	1 2 3 4			+
H						
	10%		10 1 / 0.25/	9 0.5/ 0.5-1 10		1 2 3 4
	30%					1 2 3 4
	60%			+		1 2 3 4
I	(1) (2)					
J						
K						
<p>备 注：</p> <p>1. 教学大纲 F—J 同一 不同授 教师应协同 成共同 心内 。 教学工作指导小 审 教学大纲 不宜 改。</p> <p>2. 评价方式可参 下列方式：</p> <p>(1) 评价：平 小 、 中 、</p> <p>(2) 实作 价： 作业、实作成品、日常 、 、 察</p> <p>(3) 价：书 报告、专</p> <p>(4) 口 价：口头报告、口</p>						

_____ ()

					2
			48		32
A					
B	PCB RFIC/MMIC EDA PCB PCB PCB /				
C	1. 2. 3.				

	4.					
D						
E						
				2	2	4
				2	4	6
				4	4	12
				2	4	12
				4	6	8
				2	4	6
				0	8	8
				16	32	48
F	_____					
G				3		
	1					
	2					+
3					+	

	4					+
	5					+
	6					+
	7					
H						
	30%				1 2 3 4	
	60%				1 2 3 4	
I						
J						
K						

备 ：

1. 教学大纲 F—J 同一 不同授 教师应协同 成共同 心内 。 教学工作指导小 审 教学大纲 不宜 改。

2. 评价方式可参 下列方式：

(1) 评价：平 小 、 中 、

(2) 实作 价： 作业、实作成品、日常 、 、 察

(3) 价：书 报告、专

(4) 口 价：口头报告、口
